



# Ceiling Fact Sheets

천장 Suspended Ceilings

타공판 Perforated board

**Application:** Indoors and outdoors

**Support structure:** Metal

**Fastening:** Screws / rivets

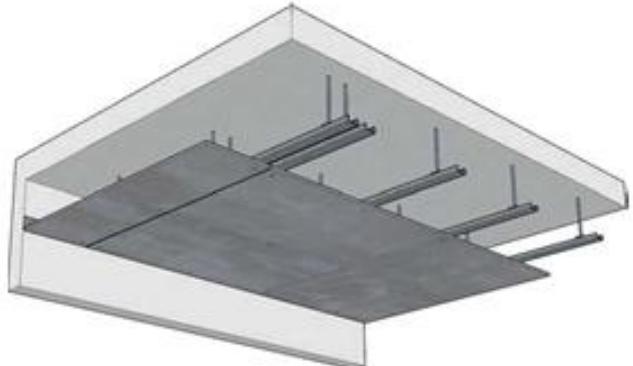
**Thickness:**

10 mm for dry indoors

12 mm for moist indoors and outdoors

**Board maximum size:**

3000 x 1250 mm



### 1. 소개

바이록은 시멘트로 결합된 파티클 보드의 일종이며 압축 건조된 소나무 파편과 시멘트로 구성된 신소재입니다. 포틀랜드 시멘트, 목재입자(소나무), 물, 색소 등으로 구성되어 있는 바이록은 나무가 가진 저항력, 유연성과 더불어 시멘트의 지속성과 견고함을 동시에 갖춰 넓은 범위의 제품 적용을 가능하게 합니다. 또한 시공과 건축 분야에서 기술적 해결법을 제시함과 동시에 다양한 미적 요구 및 디자인까지 충족시킵니다.

### 2. 투습 저항력

바이록은 습도에 따른 변화율이 낮습니다. 습도와 온도 변화에 따라 예상되는 보드의 최대 크기 변화는 0.5‰에서 -1.0‰입니다. 모서리에서의 고정은 반드시 이러한 크기 변화를 고려하여야 합니다.

### 3. 설치 조건

천장(이중천장)은 실내와 실외 모두에서 사용됩니다. 현장관리자는 반드시 설치 전 직사광선을 피한 건조한 장소에서 보드를 48시간 동안 노출시켜야 하며 적합한 설치를 위한 지지 구조의 상태 또한 확인하여야 합니다.

### 4. 지지 구조

아연 도금철의 금속질 재료는 보드를 지지하는 용도로 사용할 수 있습니다. 지지대 간 거리는 보드의 두께에 따라 결정되지만 600mm를 넘길 수 없습니다. 또한 지지대의 부품들은 충분한 공간과 함께 반드시 보드의 가장 긴 변에 대해 수직으로 정렬되어야 하며 보드는 휘어진 상태로 사용될 수 없습니다.

### 5. 고정

바이록은 나사와 리벳으로 고정할 수 있습니다. 실외 설치 시 반드시 스테인리스스틸 또는 알루미늄 나사류만 허용됩니다. 실내에서 설치할 때, 부식의 위험이 없을 경우 단순 아연 도금된 재료를 사용할 수 있습니다. 모서리와 나사 위치 사이의 거리는 반드시 최소 50mm, 보드 사이의 이음매는 최소 5mm를 유지해야 합니다.

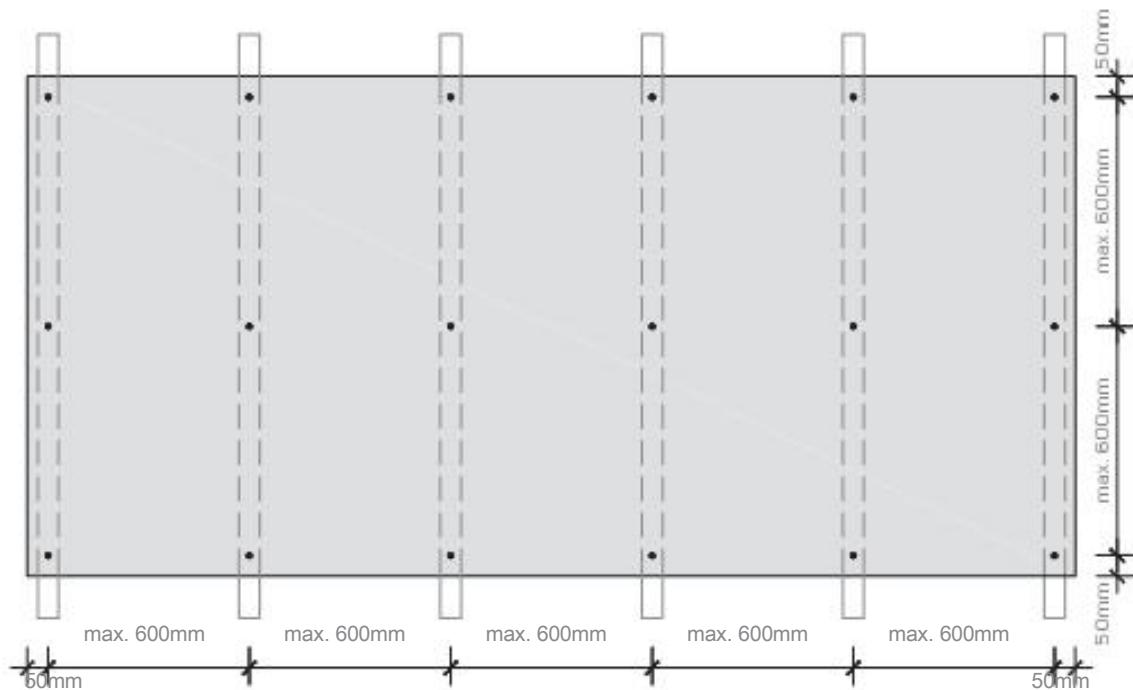
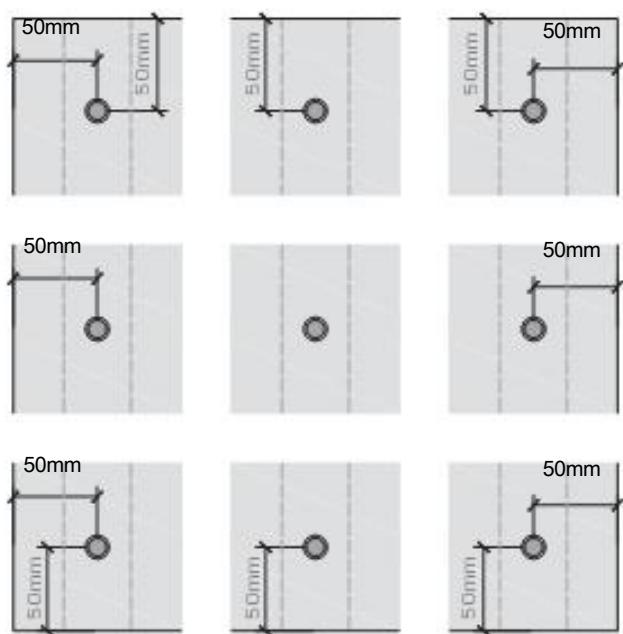
### 6. 표면 처리

바이록은 페인트와 바니쉬 등으로 마감할 수 있습니다. 패널 표면에 바니쉬 작업을 진행하기 전 반드시 각종 수지, 먼지, 가루 등이 없는 깨끗하고 건조한 상태여야 합니다. 첫번째 표면처리는 반드시 보드의 양면과 모서리를 포함하여야 하며 이후의 표면처리는 노출된 면과 가장자리만 진행하면 됩니다.

**Notes & recommendations**

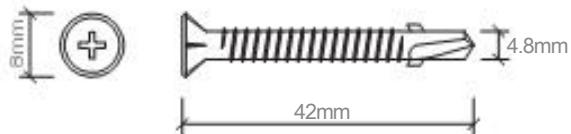
바이록 보드의 내성과 특성을 이해하기 위해 생산정보지침서를 참고하십시오.

항상 표준안정규정과 해당지역 법률규정을 준수하십시오.

**7. 고정 위치****8. 모서리와 고정위치 간 거리**

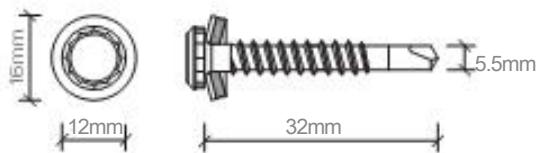
## 9. 실외용 고정장치

EMET C 8 - 4.8 x42

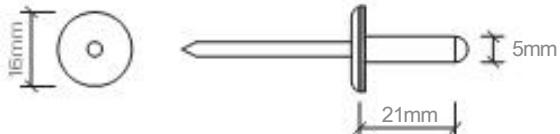


Alternative screws for exterior

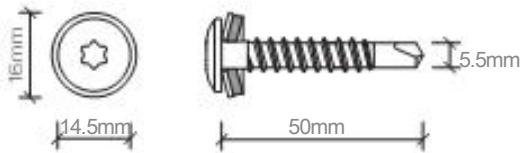
EMET V 12-A16 - 5.5x 32



Rivet C 16 -W 16 - 5x 2 1

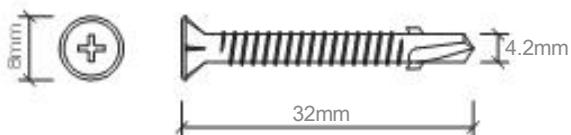


EMET C 14 -A16 - 5.5x 50

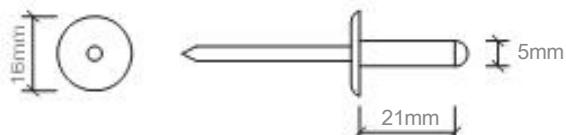


## 10. 실내용 고정장치

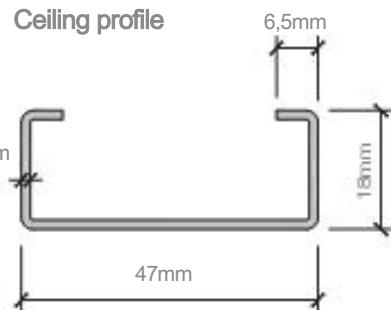
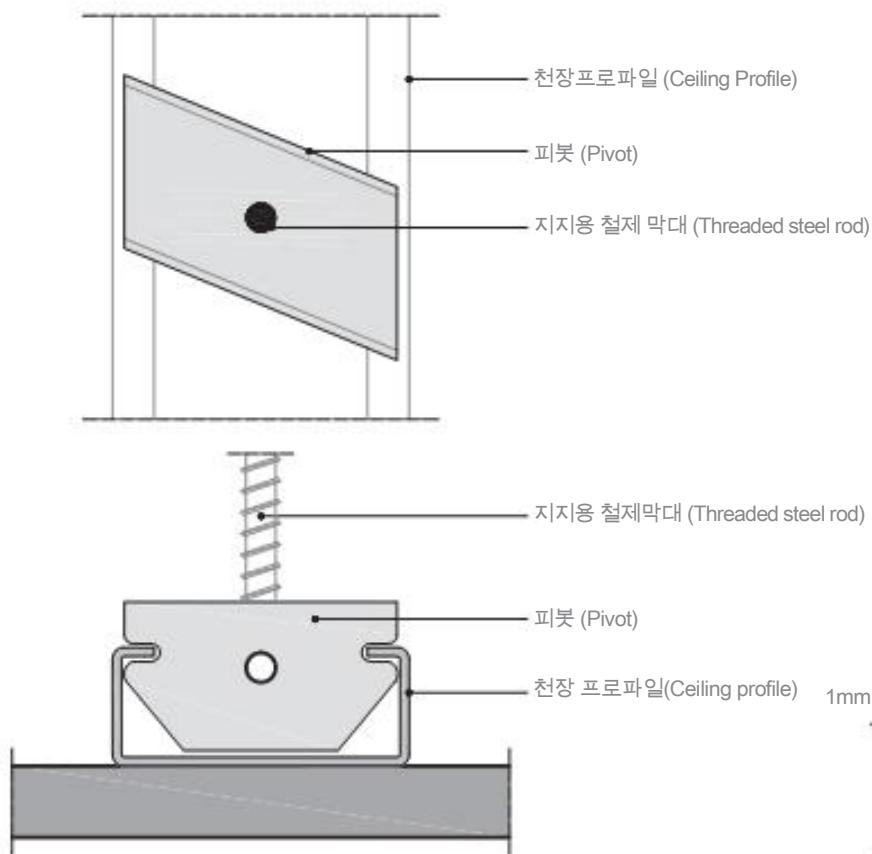
IMET C 8 - 4. 2 x 32



Rivet C16-5x 2 1

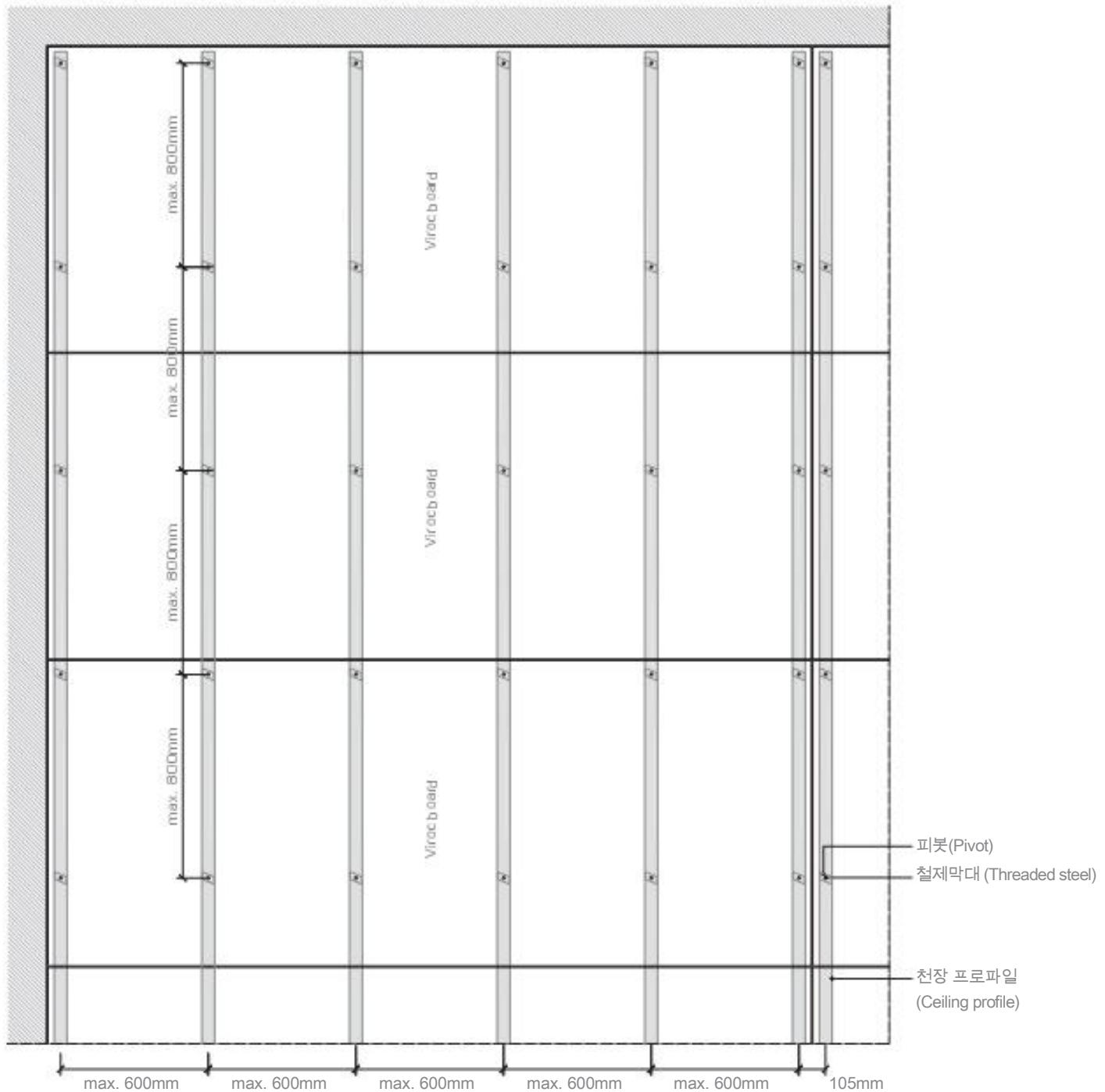


## 11. 피봇 상세 (Pivot detail)



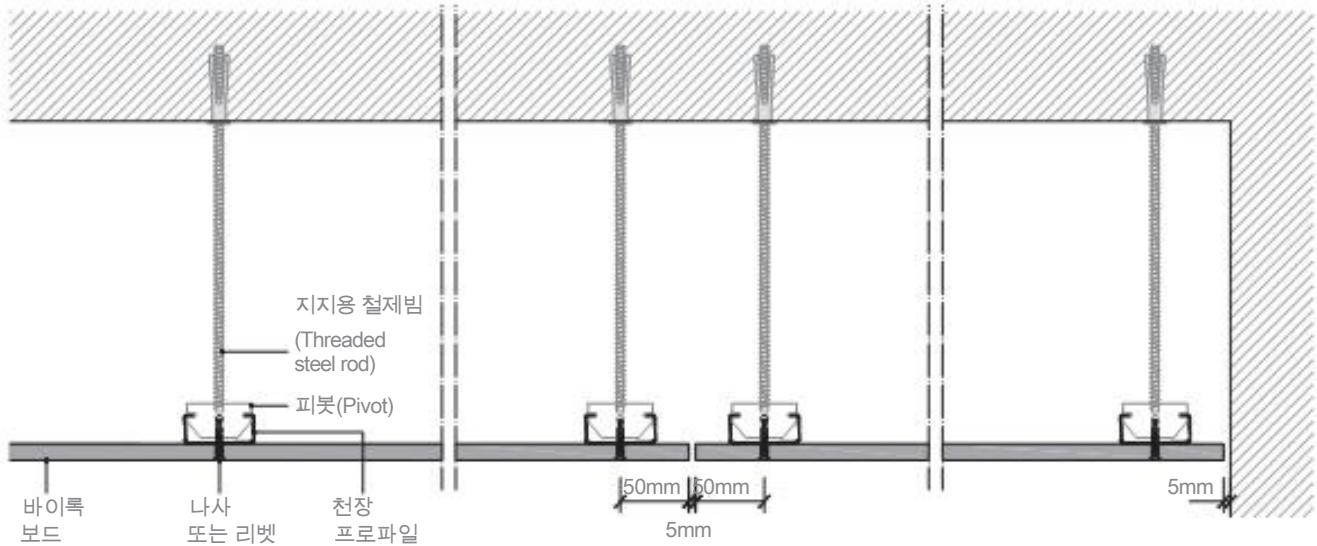


## 12. 지지 구조

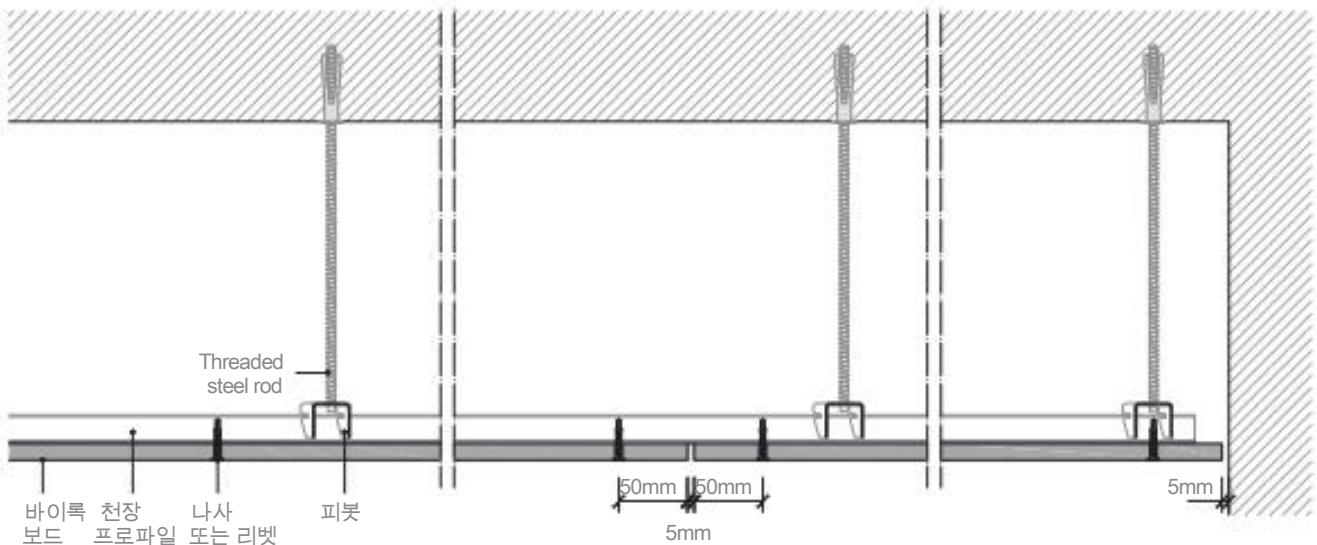


### 13. 시공 상세

횡단부 (Transversal section)

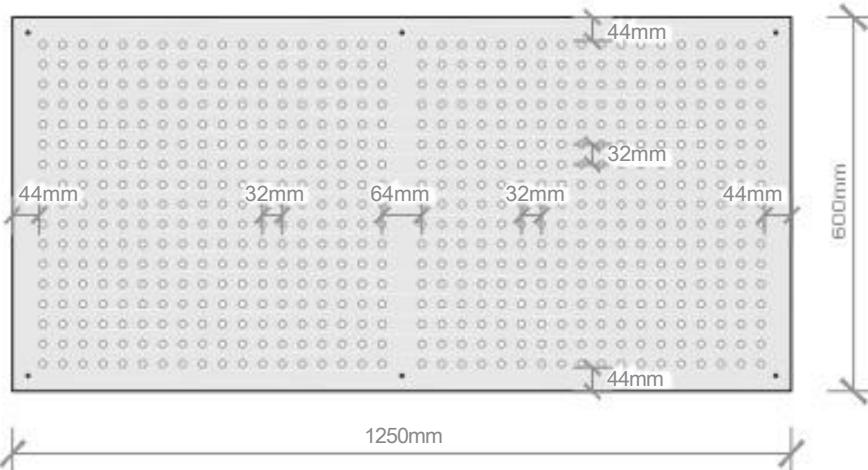


종단부 (Longitudinal section)

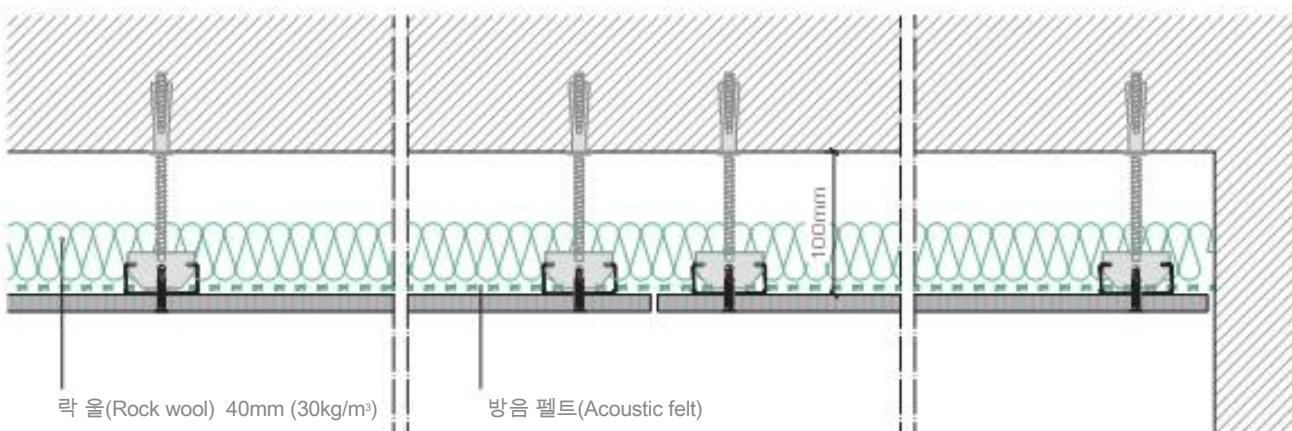


#### 14. 흡음

바이록 보드 크기 : 1250x600x12mm  
 타공 : 지름 12mm, 길이 32mm



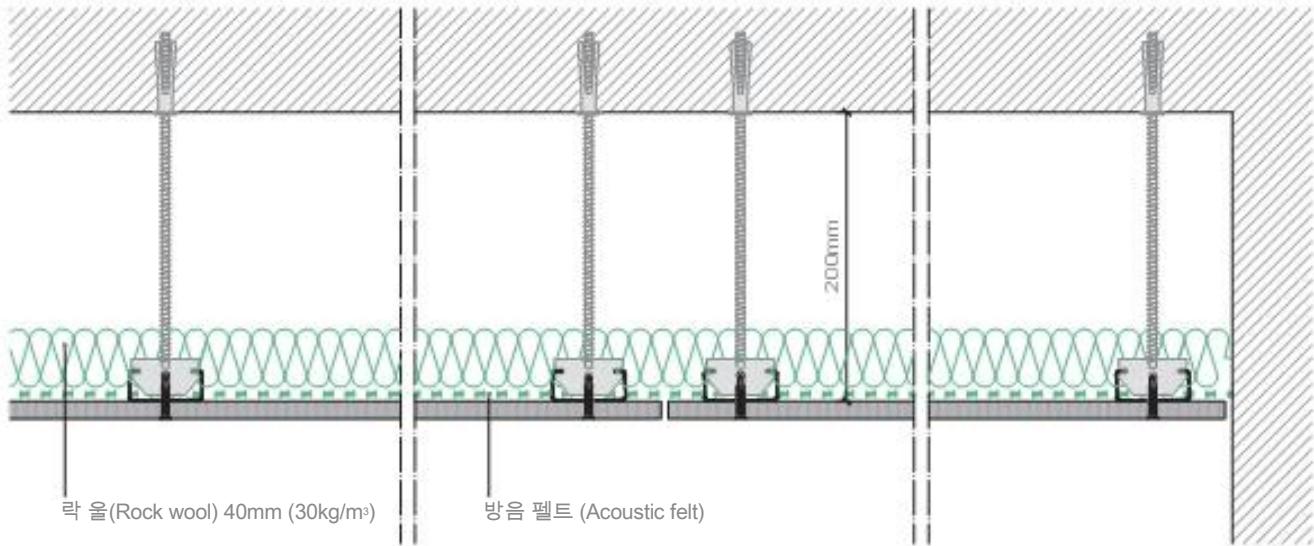
#### 14.1 천장과 보드 사이 거리 : 100mm



#### 흡음지수 (I) - EN ISO 354

f (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
I	0.00	0.14	0.24	0.50	0.69	0.83	0.86	0.81	0.67	0.56	0.49	0.43	0.36	0.29	0.28	0.23	0.24	0.07

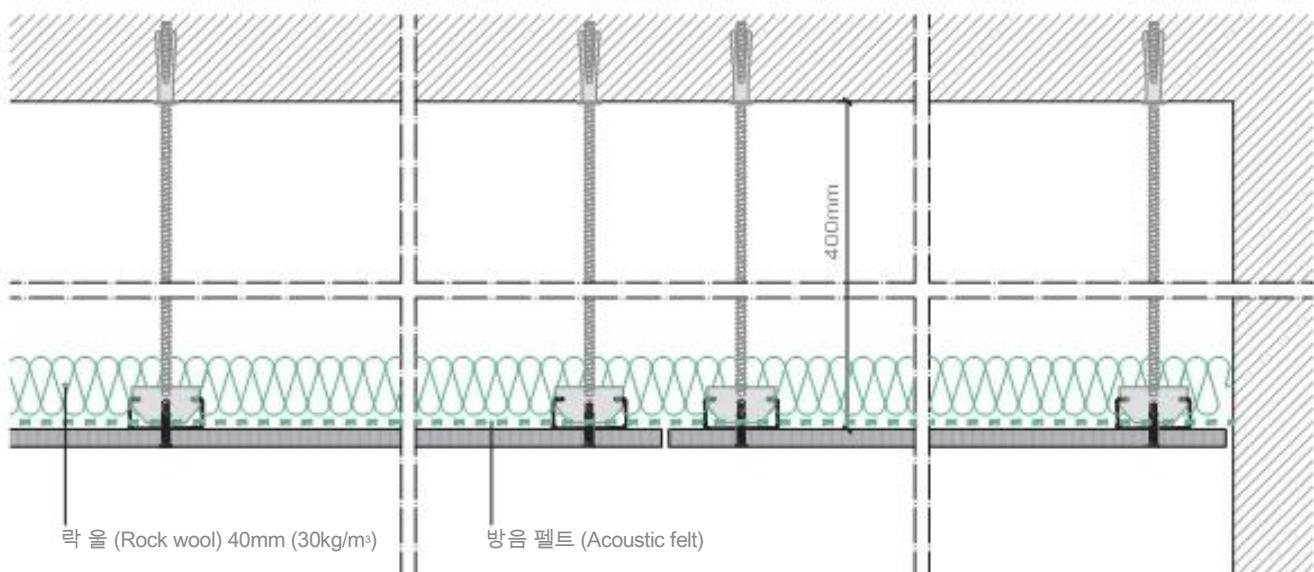
## 14.2 천장과 보드 사이 거리 : 200mm



## 흡음지수 (I) - EN ISO 354

f (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
I	0.23	0.37	0.53	0.78	1.00	0.80	0.80	0.72	0.69	0.64	0.60	0.48	0.37	0.29	0.27	0.23	0.25	0.10

## 14.3 천장과 보드 사이 거리 : 400mm



## 흡음지수 (I) - EN ISO 354

f (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
I	0.74	0.71	0.86	0.71	0.77	0.67	0.67	0.76	0.76	0.72	0.62	0.50	0.38	0.28	0.27	0.20	0.21	0.01

## Perforated board



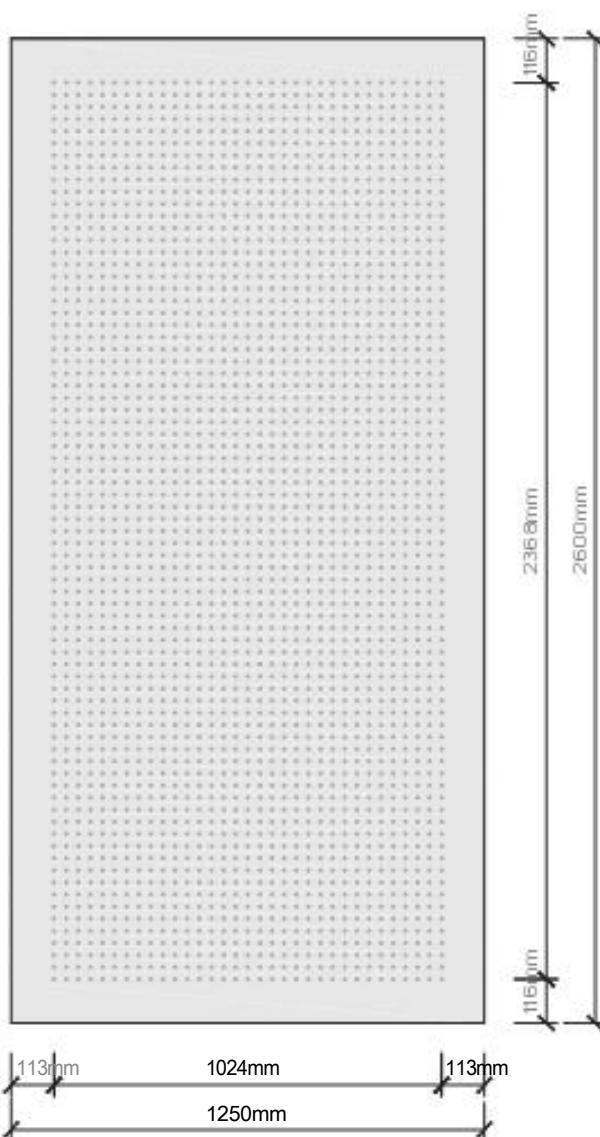
크기 : 2600x1250mm

타공 : 2475

타공 지름 : 8 mm

경간 : 32 mm

타공률 : 3,83%



## Perforated board



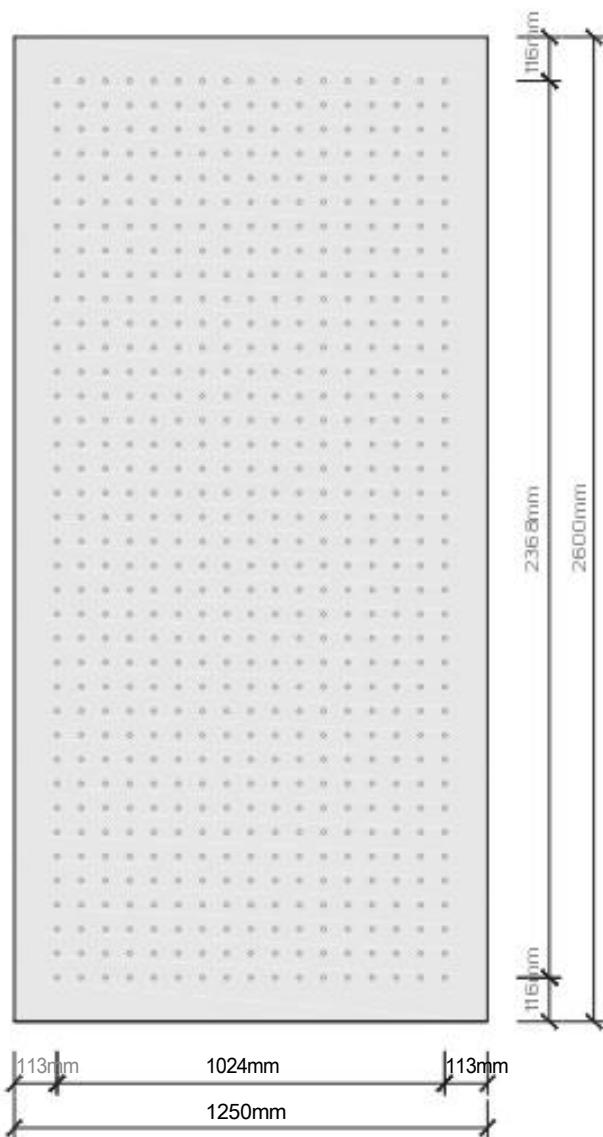
크기 : 2600x1250mm

타공 : 646

타공 지름 : 12 mm

경간 : 64 mm

타공률 : 2,25%





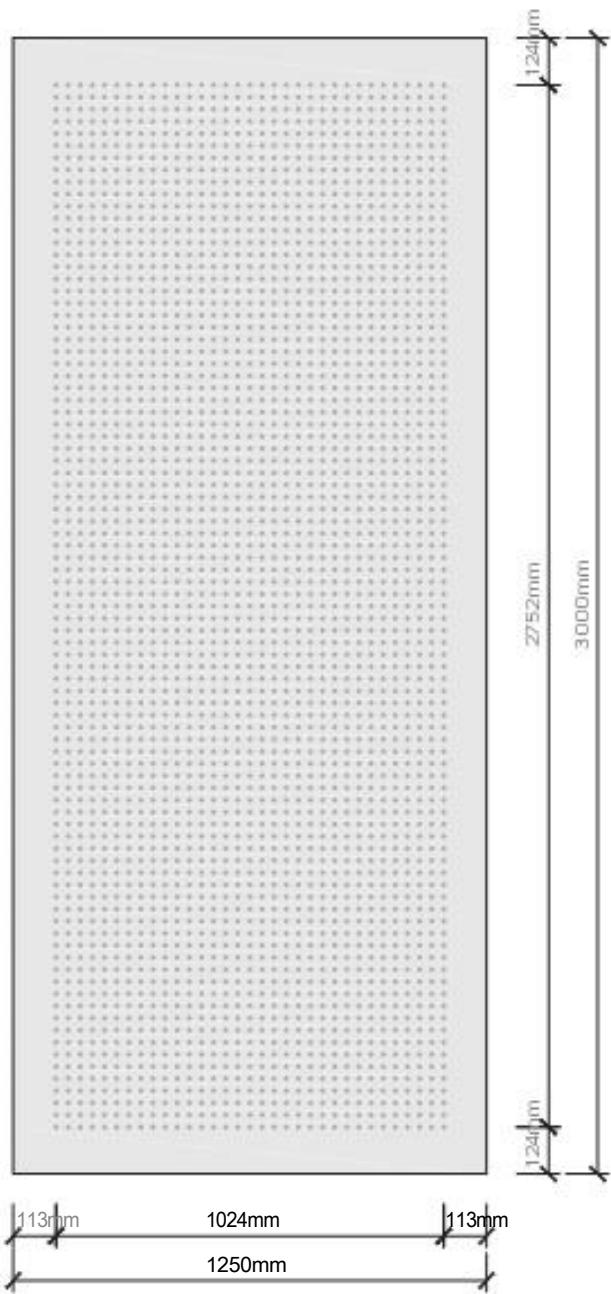
크기 : 3000x1250mm

타공 : 2871

타공 지름 : 8 mm

경간 : 32 mm

타공률 : 3,85%



## Perforated board



크기 : 3000x1250mm

타공 : 748

타공 지름 : 12 mm

경간 : 64 mm

타공률 : 2,26%

